



BT2S 模组规格书

文档版本: 20220602

[查看在线版本](#)



目录

1 产品概述	2
1.1 特点	2
1.2 主要应用领域	2
1.3 更新说明	2
2 模组接口	3
2.1 尺寸封装	3
2.2 引脚定义	5
3 电气参数	7
3.1 绝对电气参数	7
3.2 工作条件	7
3.3 工作模式下功耗	7
4 射频参数	9
4.1 基本射频特性	9
4.2 RF 输出功率	9
4.3 RF 接收灵敏度	9
5 天线信息	11
5.1 天线类型	11
5.2 降低天线干扰	11
6 封装信息及生产指导	12
6.1 机械尺寸和背面焊盘尺寸	12
6.2 生产指南	14
6.3 推荐炉温曲线和温度建议	15
6.4 储存条件	16
7 模组 MOQ 与包装信息	18



BT2S 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式的蓝牙模组。它主要由一个高集成度的蓝牙芯片 TLSR8250F512ET32 和少量的外围电路构成，内置了蓝牙网络通信协议栈和丰富的库函数。



1 产品概述

BT2S 还包含低功耗的 32 位 MCU，蓝牙 LE5.0/2.4G Radio，4Mbits flash，48Kbyte SRAM.

1.1 特点

- 内置低功耗 32 位 MCU，可以兼作应用处理器。
- 主频支持 48 MHz
- 工作电压：1.8V-3.6V，在 1.8V 到 2.7V 之间，模组可以启动，但是无法保证最优射频性能；在 2.8V-3.6V 之间，模组整体性能正常。
- 外设：5×GPIOs, 1×UART, 1×ADC
- 蓝牙 LE RF 特性
 - 兼容 BLE 4.2/5.0
 - 射频数据速率高达 2Mbps
 - TX 发射功率：+10dBm
 - RX 接收灵敏度：-94 dBm@ 蓝牙 LE 1Mbps
 - 内嵌硬件 AES 加密
 - 搭配板载 PCB 天线，天线增益 0.89dB
 - 工作温度：-20°C to +85°C

1.2 主要应用领域

- 智能 LED
- 智能家居
- 智能低功耗传感器

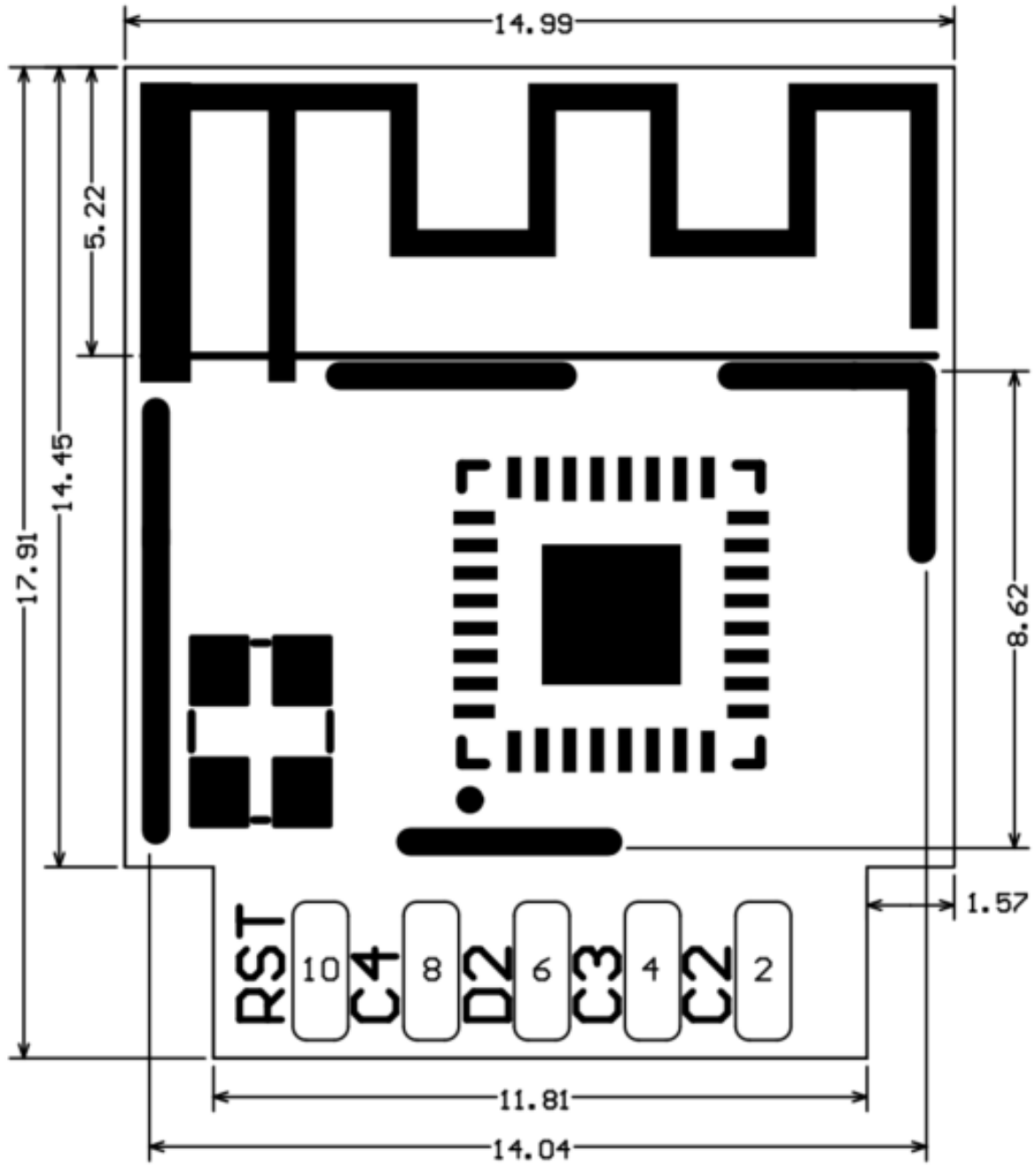
1.3 更新说明

更新日期	更新内容	更新后版本
2020-3-4	新建文档	V1.0.0

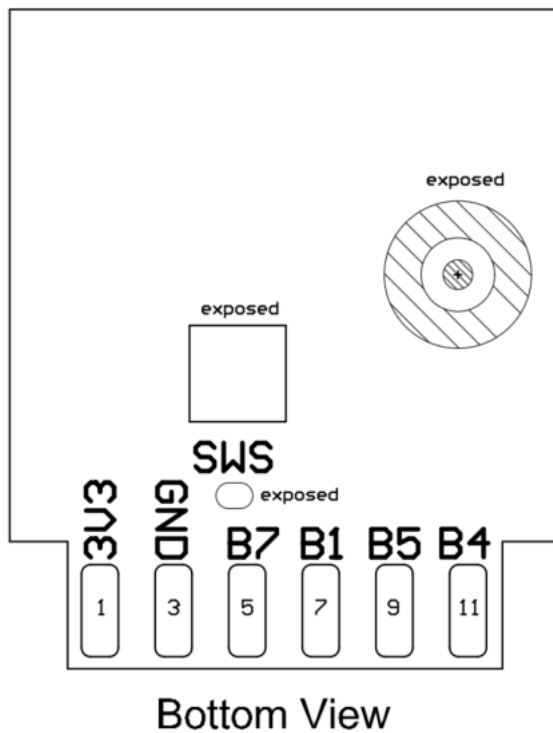
2 模组接口

2.1 尺寸封装

BT2S 共有 2 排引脚，引脚间距 2mm。BT2S 尺寸大小： $15\pm 0.35\text{mm}$ (W) $\times 18\pm 0.35\text{mm}$ (L) $\times 2.9\pm 0.15\text{mm}$ (H)，其中 PCB 厚度 $0.8\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$ ，如图所示：



Top View



2.2 引脚定义

接口引脚定义如下表所示：

序号	符号	IO 类型	功能
1	3V3	P	模组电源引脚
2	C2	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 PC2.
3	GND	P	电源参考地
4	C3	I/O	普通 IO 口，可做 LED 的驱动 PWM 输出，对应 IC 的 PC3.
5	B7	I/O	UART_RX, 对应 IC 的 PB7.

序号	符号	IO 类型	功能
6	D2	I/O	普通 IO 口, 可做 LED 的驱动 PWM 输出, 对应 IC 的 PD2.
7	B1	I/O	UART_TX, 对应 IC 的 PB1.
8	C4	AI	SAR ADC Input, 对应 IC 的 PC4.
9	B5	I/O	普通 IO 口, 可做 LED 的驱动 PWM 输出, 对应 IC 的 PB5.
10	RST	I/O	Reset, 对应 IC 的 pin 25.
11	B4	I/O	普通 IO 口, 可做 LED 的驱动 PWM 输出, 对应 IC 的 PB4.

说明: P 表电源引脚, I/O 表示输入输出引脚。如对 PWM 输出控制的灯色有自己的需求, 请与我司商务联系。

3 电气参数

3.1 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-65	150	°C
VCC	供电电压	-0.3	3.9	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-	2	KV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-	0.5	KV

3.2 工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-20	-	85	°C
VCC	工作电压	2.8	3.3	3.6	V
VIL	IO 低电平输入	VSS	-	VCC*0.3	V
VIH	IO 高电平输入	VCC*0.7	-	VCC	V
VOL	IO 低电平输出	VSS	-	VCC*0.1	V
VOH	IO 高电平输出	VCC*0.9	-	VCC	V

3.3 工作模式下功耗

符号	条件	最大值 (典型值)	单位
I _{tx}	连续发送, 11.5dBm 输出功率	23.5	mA
I _{rx}	连续接收	6.5	mA
IDC	Mesh 联网工作状态 下 Average 值	6.59	mA
IDC	Mesh 联网工作状态 下 Peak 值	24.9	mA
I _{deepsleep1}	深度休眠模式 (保留 16KBRAM)	1.2	μA
I _{deepsleep2}	深度休眠模式 (不保 留 RAM)	0.4	μA

4 射频参数

4.1 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.4GHz ISM band
无线标准	蓝牙 LE 4.2/5.0
数据传输速率	1Mbps,2Mbps
天线类型	板载 PCB 天线

4.2 RF 输出功率

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率	-21	10	11.5	dBm
20dB 调制信号 带宽 (1M)	-	2500	-	KHz
20dB 调制信号 带宽 (2M)	-	1400	-	KHz

4.3 RF 接收灵敏度

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度 1Mbps	-	-94	-	dBm
RX 灵敏度 2Mbps	-	-91	-	dBm
频率偏移误差 1Mbps	-250	-	+300	kHz



参数项	最小值	典型值	最大值	单位
频率偏移误差 2Mbps	-300	-	+200	kHz
同信道干扰抑制	-	-	-10	dB

5 天线信息

5.1 天线类型

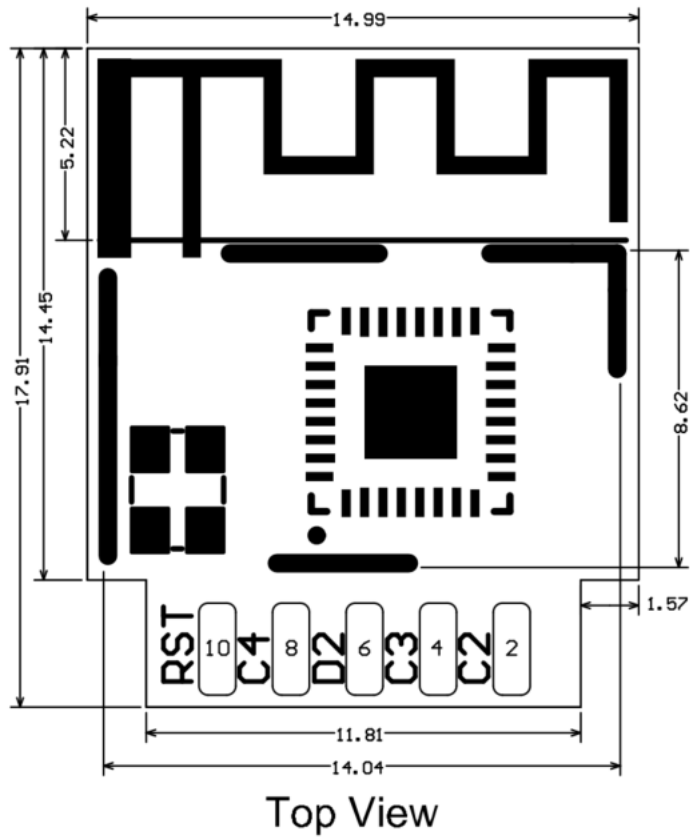
BT2S 使用的是板载 PCB 天，天线增益 0.89dBi。

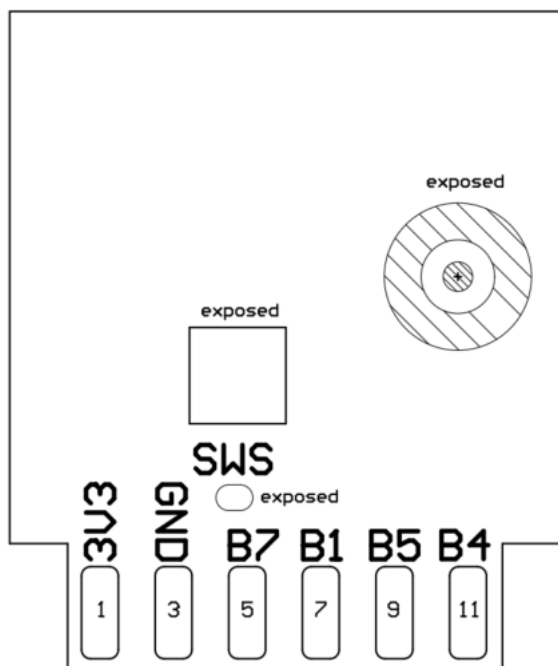
5.2 降低天线干扰

为确保 RF 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件的距离至少保持 15mm 以上。如果使用环境的天线周边包裹金属材料等，会极大地衰减无线信号，进而恶化射频性能。成品设计时，注意给天线区域预留出足够的空间。

6 封装信息及生产指导

6.1 机械尺寸和背面焊盘尺寸





Bottom View



单位: mm

模组外形公差: $\pm 0.35\text{mm}$

板厚公差: $\pm 0.1\text{mm}$

屏蔽盖高度公差: $\pm 0.05\text{mm}$

Unit: mm

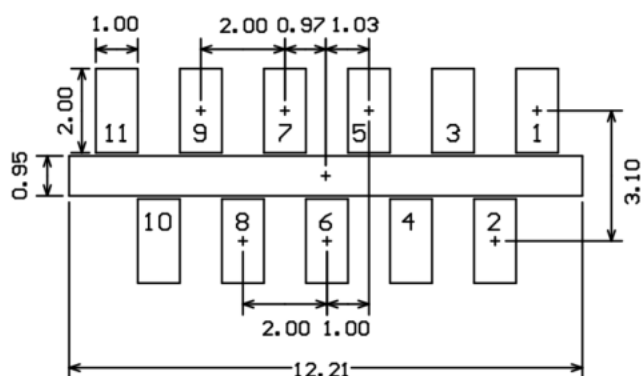
Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$

PCB thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

Shield cover height tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

Side View

推荐封装 Recommended footprint



备注：默认的模组外形尺寸公差为 ± 0.35 mm，关键尺寸公差 ± 0.1 mm。

6.2 生产指南

1. 涂鸦出厂的直插式模组建议优先使用波峰焊接设备焊接，在无法使用波峰焊接设备焊接时才使用手工焊接，拆开包装后建议在 24 小时内完成焊接，否则需放置在湿度不超过 10%RH 的干燥柜内，或重新进行真空包装并记录暴露时间，总暴露时间不超过 168 小时。
2. 焊接所需设备和材料：
 - 波峰焊设备
 - 波峰焊接治具
 - 恒温烙铁
 - 锡条、锡丝、助焊剂
 - 炉温测试仪
3. 烘烤所需仪器或设备：
 - 柜式烘烤箱
 - 防静电耐高温托盘
 - 防静电耐高温手套
4. 涂鸦出厂的模组当出现可能受潮的情况下需要进行烘烤：
 - 拆封前发现真空包装袋破损

- 拆封后发现包装袋内没有湿度指示卡
- 拆封后如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色
- 拆封后总暴露时间超过 168 小时
- 从首次密封包装之日起超过 12 个月

5. 烘烤参数如下：

- 烘烤温度：卷盘包装 60°C，小于等于 5%RH；托盘包装 125°C，小于等于 5%RH（耐高温托盘非吸塑盒拖盘）
- 烘烤时间：卷盘包装 48 小时；托盘包装 12 小时
- 报警温度设定：卷盘包装 65°C；托盘包装 135°C
- 自然条件下冷却到 36°C 以下后，即可进行生产
- 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完，请再次进行烘烤
- 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用波峰焊接工艺焊接此批次模组，因模组为 3 级湿敏器件超过允许的暴露时间很可能受潮，进行高温焊接时可能导致器件失效或焊接不良。

6. 在整个生产过程中请对模组进行静电放电（ESD）保护。

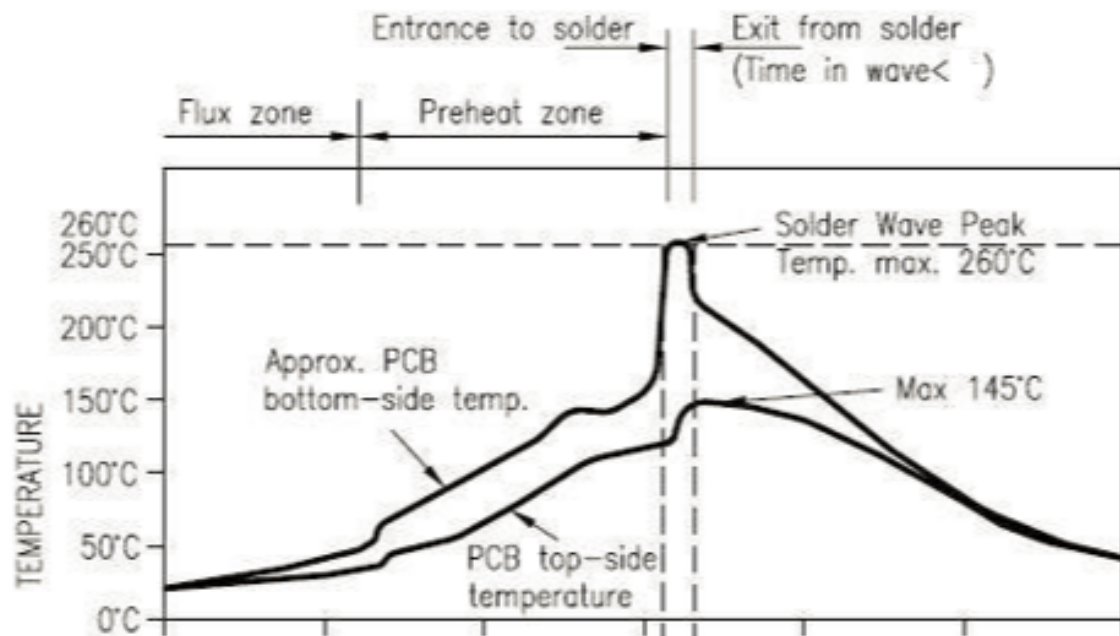
7. 为了确保产品的良好品质，生产时需重点关注助焊剂的喷涂量，波峰高度，波峰焊锡缸内的锡渣和铜含量是否超标，波峰焊接治具开窗和治具厚度是否合适以及波峰焊接炉温曲线的合理性。

6.3 推荐炉温曲线和温度建议

请参考波峰焊接炉温建议进行炉温设定，峰值温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，波峰焊接温度曲线如下图所示：

图 8 炉温曲线图

DIP Type Product Pass Wavesolder Graph



焊接温度建议:

波峰焊接炉温曲线建议

手工焊接温度建议

预热温度	80-130°C	焊接温度	360°C±20°C
预热时间	75-100S	焊接时间	小于 3S/点
波峰接触时间	3-5S	NA	NA
锡缸温度	260±5°C	NA	NA
升温斜率	≤2°C/S	NA	NA
降温斜率	≤6°C/S	NA	NA

6.4 储存条件

涂鸦出厂的模组存储条件如下:

- 防潮袋真空包装储存在温度 < 40°C、湿度 < 90%RH 的环境中。
- 干燥包装的产品，保质期为从包装密封之日起 12 个月的时间。



7 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	出货包装方式	每箱包装卷盘数 (盘)
BT2S	4400	载带卷盘	1100	4